



技术要求 (at25°C)

- 1.Kp: ≥ 0.58
- 2.fr: $258 \pm 10\text{kHz}$
- 3.C: $2850 \pm 10\% \text{ pF}$ (at 1KHz)
- 4.绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ min}$ (at 100VDC)
- 5.银层(阴影部分)光亮, 无缺银, 氧化等现象, 可焊性好
- 6.银层厚度: 正面 (Ag) $0.008\text{mm}-0.010\text{mm}$,
反面 (90%Ag+10%W) $0.004\text{mm}-0.005\text{mm}$
- 7.银层粘接强度: $> 5\text{N/mm}^2$

					Ø8x0.2F1被银瓷片			PZT	
标记	处数	日期	签名	更改文件号	版本号	重量	比例	KC5.001.061	
制图	江一		标准化		1.0				
设计			批准	张锦					
校对									
工艺		日期	08.09.16	第	页	共	页		